

## <mate 論文執筆要項>

### ① 論文体裁

(テンプレートをダウンロードしてご利用下さい.)

- 言語： 日本語または英語
- 字体： 英語の字体（フォント）は **Times** が原則。  
日本語の字体は明朝体とする（題目は除く）。
- 題目： 本文が日本語の場合，日本語と英語 一段組  
(字サイズ：14pt, 字体：題目の字体はゴシック体)  
※英文題目の各単語の先頭は，大文字とする（前置詞などは除く）
- 著者名・所属： 本文が日本語の場合，日本語と英語（字サイズ：9pt）
- Abstract： 英語(60～120 words) 一段組（字サイズ：9pt）
- キーワード： 英語，各単語の先頭は大文字（字サイズ：9pt）
- 本文： 日本語または英語 二段組(字サイズ：9pt, 字体：明朝体)  
一段 23～25 文字，一頁 47 行（46～49 行）。
- マージン： 上 25mm, 下左右 20mm
- 用紙： A4 白用紙を使用のこと
- Figure および Table： 必ず英語の caption を付けること。また図表中の文字は全て英語表記とする。
- ページ制限： 4 または 6 ページ（奇数頁での仕上がりは禁止する）  
ポスター概要原稿は 2 ページ
- 参考文献： 必要な参考文献を下記書式に沿って記載ください  
(例)

- 1) 川戸祐一, 有村英俊, 工藤富雄, “フォトシンタリングを利用した導電性銅ナノインクの焼結と Cu/ポリイミド界面の観察”, スマートプロセス学会誌, 2 (2013), pp.173-177.
- 2) P.S. James, H.W. Chandler, C.J. Newton, “The effect of mechanical loading on the contact resistance of coated aluminum”, A230 (1997), pp.194-201.
- 3) 梶原良一, 伊藤和利, 石居利明, “焼結 Ag 粒子ペーストを用いた鉛フリーパワー半導体パッケージの開発”, 第 16 回エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術シンポジウム論文集, 16(2010), pp.293-298.
- 4) C. Ehrhardt, M. Hutter, H. Oppermann, “Transient liquid phase soldering for lead-free joining of power modules in high temperature applications”, Proc. IMAPS International Conference and Exhibition on High Temperature Electronics, HiTEC 2012, Albuquerque, NM; United States; 8 May 2012-10 May 2012, pp.25-33.
- 5) 西岡利勝, 浜崎達也 編, プラスチック分析入門, 丸善, 2012, p.95.

○その他 :

・原稿例に沿っていない論文が多く見受けられます.体裁の詳細は「よくある間違い例(PDF)」をご確認下さい.

・仕上がりはモノクロ印刷です.モノクロ印刷で容易に判別のつく図表を掲載ください.

・「新商品」や「新合金」などの論文にはふさわしくない表現は避け、再現性がある表現をしてください。